

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



PCT

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
26. Februar 2004 (26.02.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/017697 A1**

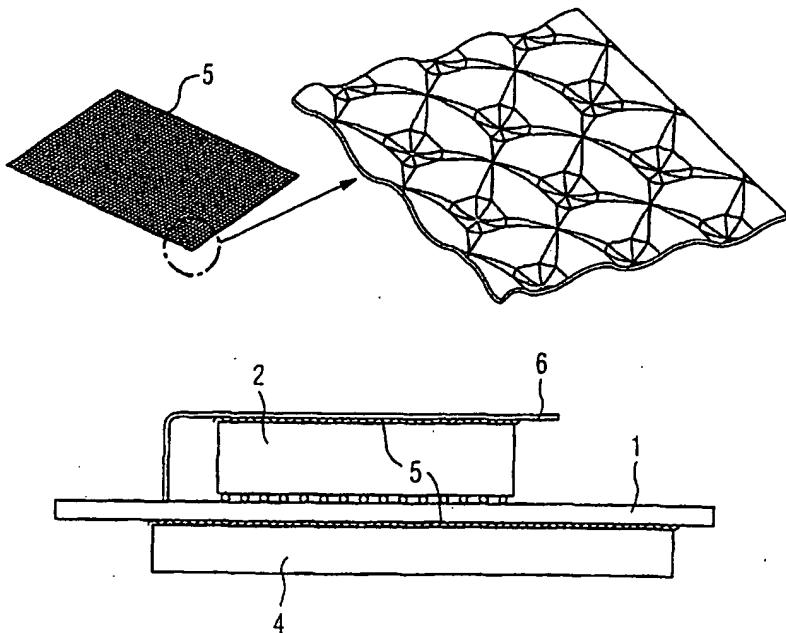
(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H05K 7/20      (72) Erfinder; und  
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002441      (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ROMAHLN, Jörg  
(22) Internationales Anmeldeatum: 16. Juli 2003 (16.07.2003)      (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).  
(25) Einreichungssprache: Deutsch      (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch  
(30) Angaben zur Priorität: 102 34 500.7 23. Juli 2002 (23.07.2002) DE  
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR HEAT DISSIPATION IN MOBILE RADIO DEVICES AND A CORRESPONDING MOBILE RADIO DEVICE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR WÄRMEABLEITUNG IN MOBILFUNKGERÄTEN UND EIN ENTSPRECHENDES MOBILFUNKGERÄT



(57) Abstract: The invention relates to a method for heat dissipation in mobile radio devices, with heat-radiating electrical components (2), whereby the heat-radiating components are brought into heat-dissipating contact with a metal film (5). The invention further relates to a mobile radio device with heat-radiating electrical components (2), whereby each component is in effective heat-dissipating contact with a metal film.

WO 2004/017697 A1

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]